



中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5980

SJ 20642/7—2000

半导体光电器件
GR1325J 型长波长发光二极管组件
详细规范

**Semiconductor optoelectronics devices
Detail specification for type GR1325J
light emitting diode module**

2000-10-20 发布

2000-10-20 实施

中华人民共和国信息产业部 批准

中华人民共和国电子行业军用标准

半导体光电器件

GR1325J 型长波长发光二极管组件

详细规范

SJ 20642/7—2000

Semiconductor optoelectronics devices

Detail specification for type GR1325J

light emitting diode module

1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 GR1325J 型长波长发光二极管组件的详细要求。

1.2 适用范围

本规范适用于 GR1325J 型长波长发光二极管组件(以下简称“组件”)的研制、生产和采购。

1.3 分类

1.3.1 产品等级

本规范提供的产品质量保证等级按 SJ 20642—97《半导体光电模块总规范》规定,为 M1 级。

2 引用文件

GB/T 12507.1—2000 光纤光缆连接器 第一部分:总规范

GB/T 15651—1995 半导体器件 分立器件和集成电路 第 5 部分 光电子器件

GJB 150.3—86 军用设备环境试验方法 高温试验

GJB 150.4—86 军用设备环境试验方法 低温试验

GJB 179A—95 计数抽样程序及表

GJB 548A—96 微电子器件试验方法和程序

GJB 601A—98 热敏电阻器总规范

GJB 1919—94 耐环境中性圆形光纤光缆连接器总规范

GJB 1428A—99 光缆总规范

SJ 2355—83 半导体发光器件测试方法

SJ 2658—86 半导体红外发光二极管测试方法

SJ 20642—97 半导体光电模块总规范

3 要求

3.1 详细要求

各条要求应符合 SJ 20642 中 M1 级和本规范的规定。

3.2 设计、结构和材料要求

3.2.1 设计

组件的设计应满足性能指标和技术图纸的规定。

3.2.2 结构

3.2.2.1 组件结构

组件由发光二极管芯片、半导体致冷器、热敏电阻、多模光缆、FC 型活动连接器等组成。

3.2.2.2 外形结构和尺寸

组件的外形结构见图 1，外形尺寸见表 1。

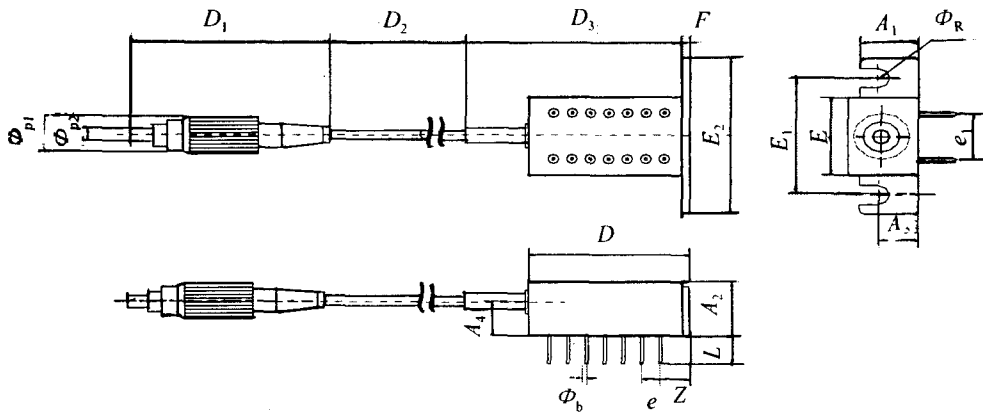


图 1 外形结构

表 1 外形尺寸

mm

符号 尺寸	A_1	A_2	A_3	A_4	ϕ_b	D	D_1	D_2	D_3	ϕ_{p1}
最小值	9.00	—	5.00	5.00	0.40	21.00	—	1000.00	29.00	9.5
公称值	—	—	—	—	—	—	40.00	—	—	—
最大值	12.00	12.00	6.30	8.00	0.47	23.00	—	—	31.00	10.5
符号 尺寸	E	E_1	E_2	e	e_1	ϕ_R	F	L	Z	ϕ_{p2}
最小值	12.00	19.00	25.00	—	—	1.50	1.00	4.00	3.50	—
公称值	—	—	—	2.54	7.62	—	—	—	—	2.5
最大值	13.00	19.50	26.00	—	—	1.70	2.00	—	4.00	—